

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: **0737700100**
Status: **Active**
Overview: HDM® Backplane Connector System
Description: HDM® Board-to-Board Stacking Header, High Rise Vertical, SMC, Closed End Option, 72 Circuits

Documents:

[3D Model](#) [Product Specification PS-73780-999 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

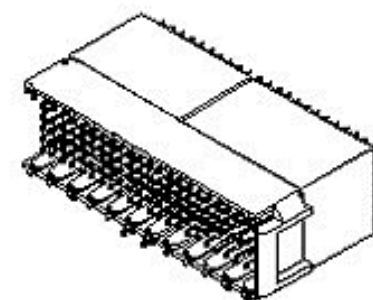
CSA LR19980
 UL E29179

General

Product Family Backplane Connectors
 Series 73770
 Application Backplane, Mezzanine
 Component Type PCB Header
 MolexKits Yes
 Overview HDM® Backplane Connector System
 Product Name HDM®
 UPC 800755029000

Physical

Circuits (Loaded) 72
 Circuits (maximum) 72
 Color - Resin Black
 Durability (mating cycles max) 200
 First Mate / Last Break No
 Flammability 94V-0
 Guide to Mating Part No
 Keying to Mating Part None
 Material - Metal Phosphor Bronze
 Material - Plating Mating Gold
 Material - Plating Termination Tin-Lead
 Material - Resin High Temperature Thermoplastic
 Net Weight 13.179/g
 Number of Columns 12
 Number of Pairs Open Pin Field
 Number of Rows 6
 Orientation Vertical
 PC Tail Length 3.50mm
 PCB Locator No
 PCB Retention None
 PCB Thickness - Recommended 1.40mm
 Packaging Type Tube
 Pitch - Mating Interface 2.00mm
 Pitch - Termination Interface 2.00mm
 Plating min - Mating 0.762µm
 Plating min - Termination 0.381µm
 Polarized to PCB No
 Stackable Yes
 Surface Mount Compatible (SMC) Yes
 Temperature Range - Operating -55°C to +105°C
 Termination Interface: Style Through Hole - Compliant Pin



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC(2014 December 17): No

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
 Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

Search Parts in this Series

73770 Series

Mates With

73632 HDM PLUS® Board-to-Board Daughtercard Receptacle. 73780 HDM® Board-to-Board Daughtercard Receptacle

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

| Description | Product # |
|---------------------|-------------------|
| Extraction Tool | <u>0621001000</u> |
| Backplane Insertion | <u>0621001400</u> |
| Signal Contact Tool | |

Electrical

| | |
|-------------------------------|----------|
| Current - Maximum per Contact | 1.0A |
| Data Rate | 1.0 Gbps |
| Real Signals (per 25mm) | 72 |
| Voltage - Maximum | 250V AC |

Solder Process Data

| | |
|------------------------------|-----|
| Lead-free Process Capability | N/A |
|------------------------------|-----|

Material Info**Reference - Drawing Numbers**

| | |
|-----------------------|--------------|
| Product Specification | PS-73780-999 |
| Sales Drawing | SD-73770-001 |

HDM and High Density Metric are trademarks of Amphenol Corporation

This document was generated on 07/02/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.